

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-172634

(43)Date of publication of application : 20.06.2003

(51)Int.Cl.

G01D 5/14

(21)Application number : 2001-371774

(71)Applicant : AISIN SEIKI CO LTD
TOYOTA MOTOR CORP

(22)Date of filing : 05.12.2001

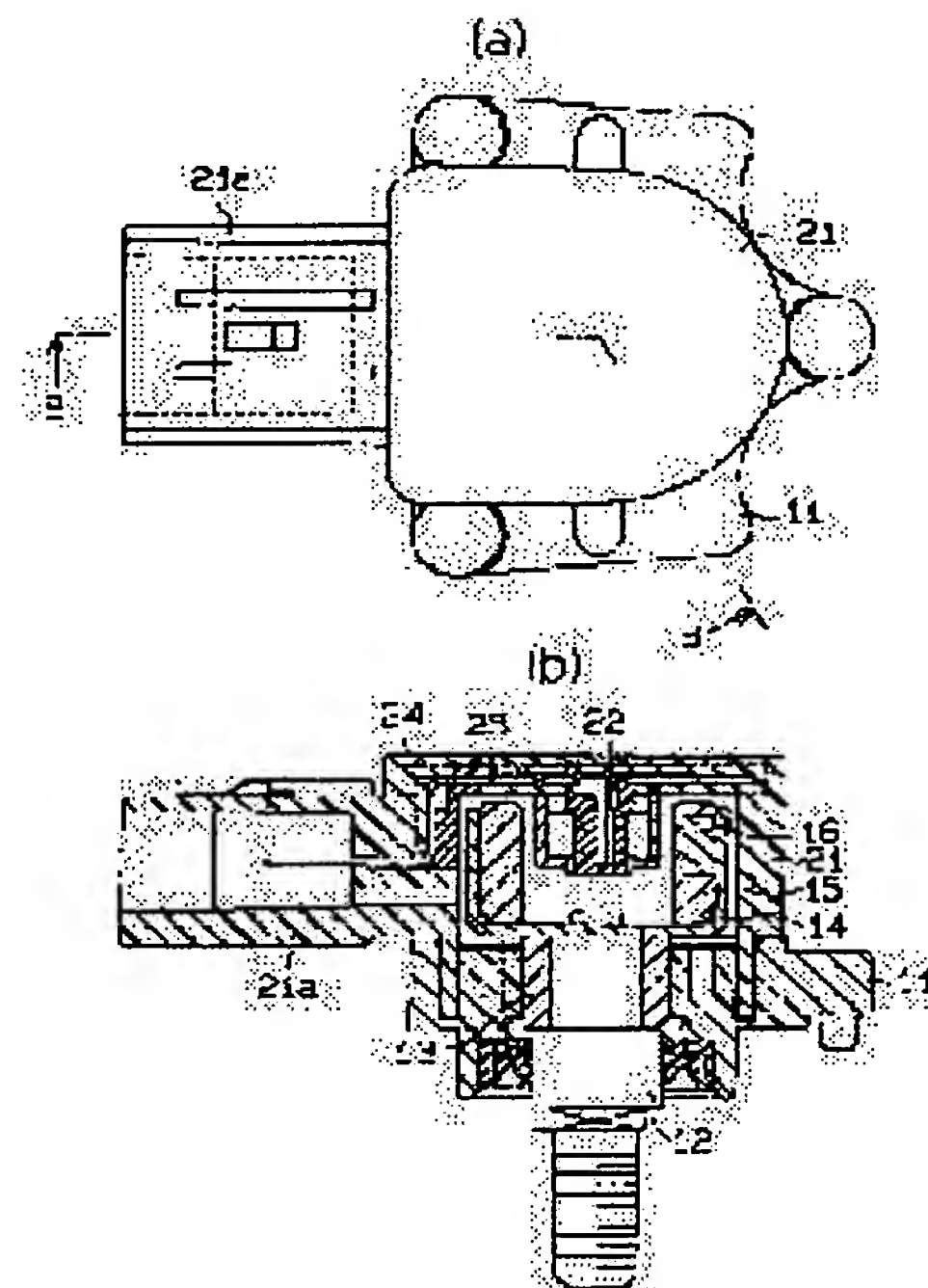
(72)Inventor : YASUDA TAKASHI
KIMURA MASAHIRO
OKUYA HISAYOSHI
YADA HIDETOSHI
ITO HIROYOSHI
NISHIGUCHI MASAYUKI
MIZUNO NAOKI

(54) HOLDING STRUCTURE FOR ELECTRONIC PARTS AND HOLDING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a holding structure for electronic parts and holding method capable of improving the accuracy of positioning electronic parts.

SOLUTION: A mold 24 is insert-molded with reference of a terminal 23. The mold 24 has a cup shape 24a for positioning shape of Hall IC 22 electrically connected with the terminal 23. A connector housing 21 surrounding the mold 24 and the Hall IC 22 positioned to the mold 24 and electrically connected with the terminal is insert-molded with reference of the terminal 23.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.10.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

04.10.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2005-21191

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 02.11.2005

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-172634

(P2003-172634A)

(43) 公開日 平成15年6月20日 (2003.6.20)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テ-マコ-ト* (参考)

G 0 1 D 5/14

G 0 1 D 5/14

H 2 F 0 7 7

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願2001-371774(P2001-371774)

(22) 出願日 平成13年12月5日 (2001.12.5)

(71) 出願人 000000011

アイシン精機株式会社

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地

(71) 出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72) 発明者 保田 敬司

愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシ

ン精機 株式会社内

(74) 代理人 100068755

弁理士 恩田 博宣 (外1名)

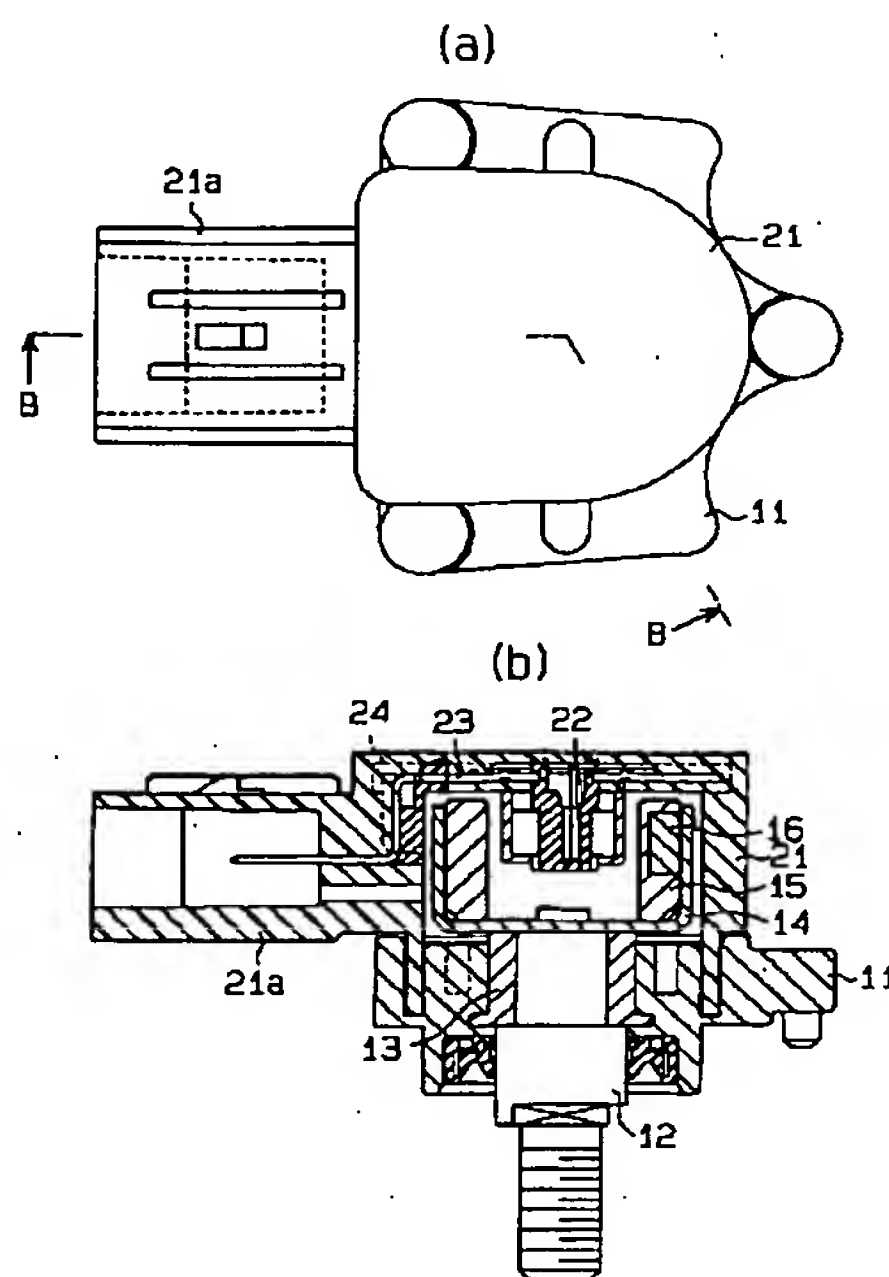
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子部品の保持構造及び電子部品の保持方法

(57) 【要約】

【課題】 電子部品の位置決め精度を向上することができる電子部品の保持構造及び電子部品の保持方法を提供する。

【解決手段】 モールド24はターミナル23を基準にインサート成形される。このモールド24は、ターミナル23と電氣的に接続されるホールIC22の位置決め形状であるカップ形状24aを有している。コネクタハウジング21は、モールド24及び同モールド24に位置決めされてターミナル23に電氣的に接続されたホールIC22を包囲してターミナル23を基準にインサート成形される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ターミナルを基準にインサート成形され、該ターミナルと電氣的に接続される電子部品の位置決め形状を有する第1樹脂モールドと、前記第1樹脂モールド及び該第1樹脂モールドに位置決めされて前記ターミナルに電氣的に接続された電子部品を包囲して該ターミナルを基準にインサート成形された第2樹脂モールドとを備えたことを特徴とする電子部品の保持構造。

【請求項2】 請求項1に記載の電子部品の保持構造において、前記位置決め形状は、前記電子部品と嵌合する嵌合形状であることを特徴とする電子部品の保持構造。

【請求項3】 請求項2に記載の電子部品の保持構造において、前記位置決め形状は、前記電子部品が嵌挿される略カップ形状であることを特徴とする電子部品の保持構造。

【請求項4】 請求項1～3のいずれかに記載の電子部品の保持構造において、前記電子部品は、回転角度に応じて発生磁束を変動させるロータに対して所定位置に配置された磁気検出素子であることを特徴とする電子部品の保持構造。

【請求項5】 ターミナルと電氣的に接続される電子部品の位置決め形状を有する第1樹脂モールドを該ターミナルを基準にインサート成形する工程と、前記第1樹脂モールド及び該第1樹脂モールドに位置決めされて前記ターミナルに電氣的に接続された電子部品を包囲する第2樹脂モールドを該ターミナルを基準にインサート成形する工程とを備えたことを特徴とする電子部品の保持方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品の保持構造及び電子部品の保持方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来、電子部品の保持構造としては、例えば特開2001-188003号公報に記載されたものが知られている。すなわち、同公報に記載の保持構造において、電子部品としてのホールIC（ホール素子）は、樹脂製のスペーサによって位置決めされている。そして、この位置決めされたホールICは、ステータコアに形成された磁束検出ギャップの中央部に配置されるとともに、その端子が溶接等によりコネクタピン（ターミナル）に接続されている。

【0003】この状態において、ホールIC、スペーサ、ステータコア及びコネクタピン等を一体で樹脂でモールド成形することにより、コネクタハウジングが形成されている。そして、このコネクタハウジングの所定位置においてホールICが保持されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような保持構造においては、ホールICとスペーサとの間の位置が決まるものの、スペーサ（及びホールIC）とコネクタピンとの間の位置決めは困難となっている。これは、スペーサとコネクタピンとが互いに別体で組み付けられることから、個々の単体での寸法ばらつきに加えて組み付け時のばらつきも更に付加されることによる。そして、コネクタハウジングにおけるホールICの配置がずれる分、例えばホールICによる磁束変動の検出精度も低下してしまう。

【0005】本発明の目的は、電子部品の位置決め精度を向上することができる電子部品の保持構造及び電子部品の保持方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、ターミナルを基準にインサート成形され、該ターミナルと電氣的に接続される電子部品の位置決め形状を有する第1樹脂モールドと、前記第1樹脂モールド及び該第1樹脂モールドに位置決めされて前記ターミナルに電氣的に接続された電子部品を包囲して該ターミナルを基準にインサート成形された第2樹脂モールドとを備えたことを要旨とする。

【0007】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の電子部品の保持構造において、前記位置決め形状は、前記電子部品と嵌合する嵌合形状であることを要旨とする。請求項3に記載の発明は、請求項2に記載の電子部品の保持構造において、前記位置決め形状は、前記電子部品が嵌挿される略カップ形状であることを要旨とする。

【0008】請求項4に記載の発明は、請求項1～3のいずれかに記載の電子部品の保持構造において、前記電子部品は、回転角度に応じて発生磁束を変動させるロータに対して所定位置に配置された磁気検出素子であることを要旨とする。

【0009】請求項5に記載の発明は、ターミナルと電氣的に接続される電子部品の位置決め形状を有する第1樹脂モールドを該ターミナルを基準にインサート成形する工程と、前記第1樹脂モールド及び該第1樹脂モールドに位置決めされて前記ターミナルに電氣的に接続された電子部品を包囲する第2樹脂モールドを該ターミナルを基準にインサート成形する工程とを備えたことを要旨とする。

【0010】（作用）請求項1～3、5のいずれかに記載の発明によれば、上記第1樹脂モールドは、ターミナルを基準にインサート成形されており、同ターミナルと電氣的に接続される電子部品の位置決め形状を有している。また、上記第2樹脂モールドもターミナルを基準にインサート成形されており、上記第1樹脂モールド及び同第1樹脂モールドに位置決めされてターミナルに電氣的に接続された電子部品を一体で包囲している。従っ

て、上記電子部品は、第1樹脂モールド（位置決め形状）及び第2樹脂モールドを介してターミナルを基準とした所定位置に位置決め配置されている。一般に、ターミナルは、樹脂材に比して変形しにくく寸法精度のよい材料（例えば、金属材）からなるため、これを基準に常に鑄型を配置して各樹脂モールド（第1及び第2樹脂モールド）をインサート成形し、電子部品の位置決めをすることで、樹脂材の寸法ばらつきによる影響が抑制される。従って、上記電子部品の位置決め精度が向上される。

【0011】なお、ここでいう包囲とは、必ずしも完全に全体を包み込むことを意味するものではなく、一部を包み込む場合も含んでいる。請求項4に記載の発明によれば、上記電子部品である磁気検出素子の位置決め精度が向上され、回転角度に応じて発生磁束を変動させるロータに対する位置決め精度が向上されることで、同回転角度の検出精度が向上される。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、本発明を具体化した一実施形態を図1及び図2に従って説明する。図1は本実施形態が適用される回転角度検出装置を示すもので、図1

(a)は平面図を、図1(b)は図1(a)のB-B線に沿った断面図をそれぞれ示している。同図に示されるように、この回転角度検出装置の本体側の筐体をなすハウジング11には、被検出物（図示略）に固定された回転軸12が軸受13を介して軸支されている。そして、この回転軸12の先端部（図1(b)において上端部）には、鉄等の磁性材料からなる略円筒状のヨーク14がカシメ等により同軸状に固着されている。このヨーク14の内周側には略円筒状の樹脂体15が同軸状に固定されており、同樹脂体15には複数の永久磁石16が埋設されている。これら回転軸12、ヨーク14、樹脂体15及び永久磁石16はロータを構成しており、被検出物の角度変化に応じて一体で回転することにより発生磁束を変動させる。

【0013】上記ハウジング11には、その上端側において第2樹脂モールドとしてのコネクタハウジング21が装着されている。このコネクタハウジング21は、その内部に埋設・保持された電子部品である磁気検出素子としてのホールIC22と電気的に接続されたターミナル23を基準にインサート成形されたものである。なお、コネクタハウジング21がハウジング11に装着された状態において、ホールIC22は後述の態様で回転軸12（ロータ）と同軸状に配置されるようになっていく。このとき、ホールIC22の周囲には上記樹脂体15にて固定された永久磁石16が配置される。従って、被検出物の角度変化に応じて回転軸12（永久磁石16）が回転すると、ホールIC22の近傍で発生する磁束が変動する。ホールIC22は、この磁束に応じた電圧を出力することで被検出物の回転角度の検出に供され

る。

【0014】次に、上記コネクタハウジング21によるホールIC22の保持構造の細部について図2を併せ参照して説明する。なお、図2は上記ターミナル23を基準にインサート成形された第1樹脂モールドとしてのモールド24を示すもので、図2(a)は平面図を、図2(b)は図2(a)のB-B線に沿った断面図をそれぞれ示している。同図に示されるように、このモールド24は上記ターミナル23の先端部23a等を現出させて成形され、その所定位置には位置決め形状及び嵌合形状としてのカップ形状24aが形成されている。このカップ形状24aは、ターミナル23を基準に配置されているのはいうまでもない。このカップ形状24aは上記ホールIC22と同等の幅及び奥行きとなる内壁面を有しており、同ホールIC22はこのカップ形状24aに挿入されてモールド24に対して位置決めされるようになっている。これにより、ホールIC22はモールド24を介してターミナル23を基準に位置決めされる。また、上記ホールIC22がモールド24に対して位置決めされた状態において、その屈曲された各端子はターミナル23と電気的に接続される。ホールIC22の各端子及びターミナル23は、例えばプロジェクション溶接等で接合される。

【0015】なお、このモールド24には、電子部品25を装着するためのカップ形状24bも併せ形成されている。そして、上記電子部品25がカップ形状24bに装着された状態において、その屈曲された端子はターミナル23と電気的に接続される。電子部品25の端子及びターミナル23も、例えばプロジェクション溶接等で接合される。

【0016】以上の態様でモールド24にホールIC22及び電子部品25が組み付けられた状態において、更に上記ターミナル23を基準に上記モールド24及びホールIC22を一体で包囲するように前記コネクタハウジング21がインサート成形される。このコネクタハウジング21は上記ターミナル23の先端部23aを現出させるとともにこれを囲むコネクタ装着部21aを有して成形される。

【0017】そして、ターミナル23を基準にコネクタハウジング21及びモールド24を介して位置決め・保持されたホールIC22は、同コネクタハウジング21がハウジング11に装着された状態において、回転軸12（ロータ）と同軸状に配置される。

【0018】以上詳述したように、本実施形態によれば、以下に示す効果が得られるようになる。

(1) 本実施形態では、モールド24は、ターミナル23を基準にインサート成形されており、同ターミナル23と電気的に接続されるホールIC22の位置決め形状（カップ形状24a）を有している。また、上記コネクタハウジング21もターミナル23を基準にインサート

成形されており、上記モールド24及びホールIC22を一体で包囲している。従って、上記ホールIC22は、モールド24（カップ形状24a）及びコネクタハウジング21を介してターミナル23を基準とした所定位置に位置決め配置されている。一般に、ターミナル23は、樹脂材に比して変形しにくく寸法精度のよい材料（例えば、金属材）からなるため、これを基準に常に鑄型を配置してモールド24及びコネクタハウジング21をインサート成形し、ホールIC22の位置決めをすることで、樹脂材の寸法ばらつきによる影響を抑制できる。従って、上記ホールIC22の位置決め精度を向上できる。

【0019】（2）本実施形態では、ホールIC22の位置決め精度が向上され、回転角度に応じて発生磁束を変動させるロータに対する位置決め精度が向上されることでその出力電圧のばらつきも抑制され、同回転角度の検出精度を向上できる。

【0020】（3）本実施形態では、モールド24に電子部品25を装着するためのカップ形状24bを形成した。従って、電子部品25の組み付け性を向上できる。

（4）本実施形態では、極めて簡易な手法にて上記ホールIC22の位置決め精度を向上できる。

【0021】なお、本発明の実施の形態は上記実施形態に限定されるものではなく、次のように変更してもよい。

・前記実施形態においては、モールド24にカップ形状24aを成形し、これにホールIC22を嵌挿してその位置決めを行った。これに対して、例えばホールIC22の周囲にカップ形状を有する部材を固定し、モールド24にこの部材に嵌挿される突起を成形してもよい。

【0022】・前記実施形態においては、モールド24にカップ形状24aを成形し、これにホールIC22を

嵌挿してその位置決めを行った。これに対して、例えばモールド24にホールIC22を係止する係止爪などを成形してその位置決めを行ってもよい。

【0023】・前記実施形態においては、磁気検出素子としてホールIC22を採用したが、例えば磁気抵抗素子を採用してもよい。

・前記実施形態においては、電子部品としてホールIC22の保持構造に本発明を具体化した。その他の電子部品の保持構造に具体化してもよい。

【0024】・前記実施形態においては、回転角度検出装置に本発明の一実施形態を適用したが、その他の装置に適用してもよい。

【0025】

【発明の効果】以上詳述したように、請求項1～3、5のいずれかに記載の発明によれば、電子部品の位置決め精度を向上することができる。

【0026】請求項4に記載の発明によれば、電子部品である磁気検出素子の位置決め精度が向上され、回転角度に応じて発生磁束を変動させるロータに対する位置決め精度が向上されることで、同回転角度の検出精度を向上できる。

【図面の簡単な説明】

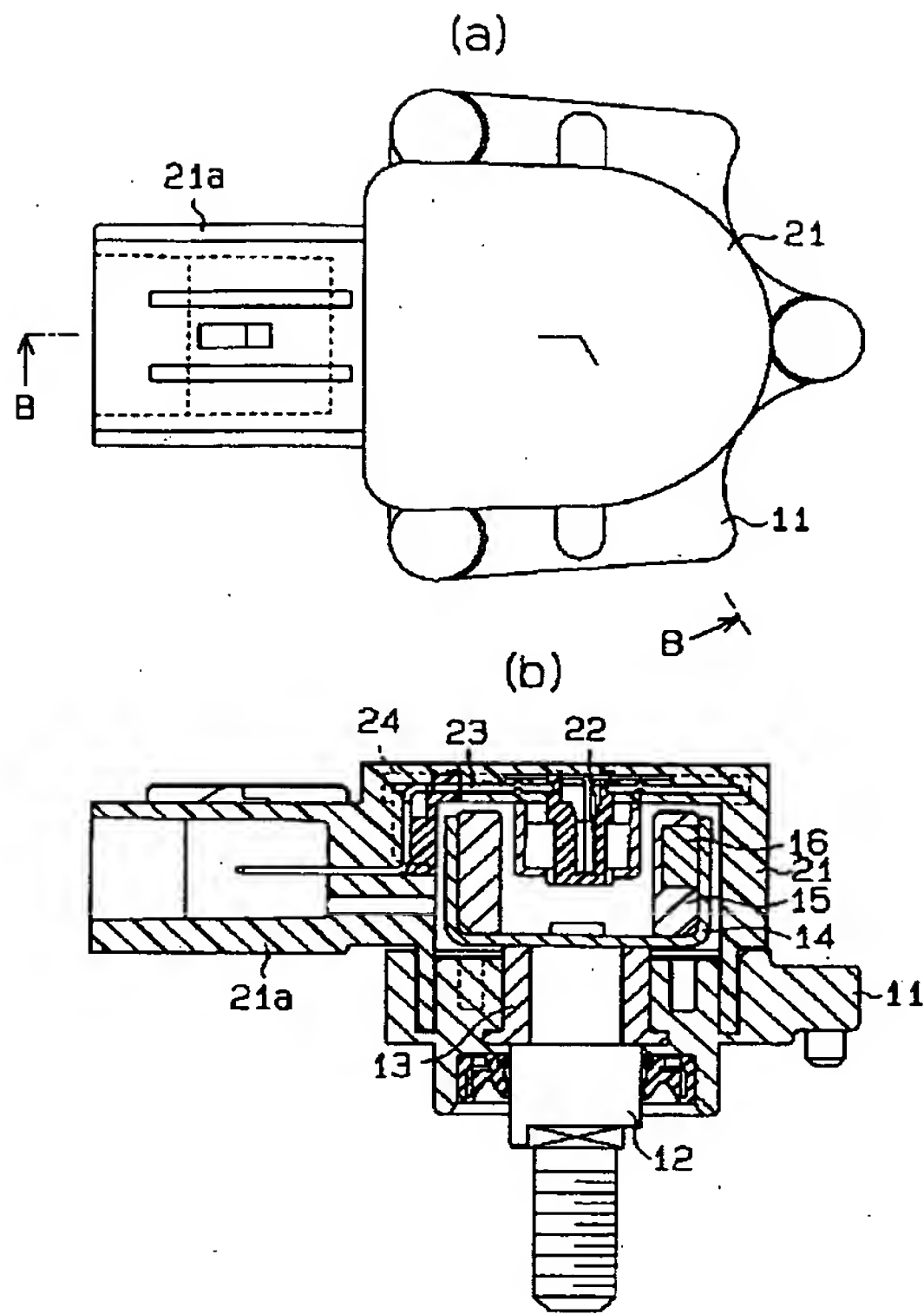
【図1】本発明の一実施形態が適用される回転角度検出装置を示す平面図及び断面図。

【図2】モールドを示す平面図及び断面図。

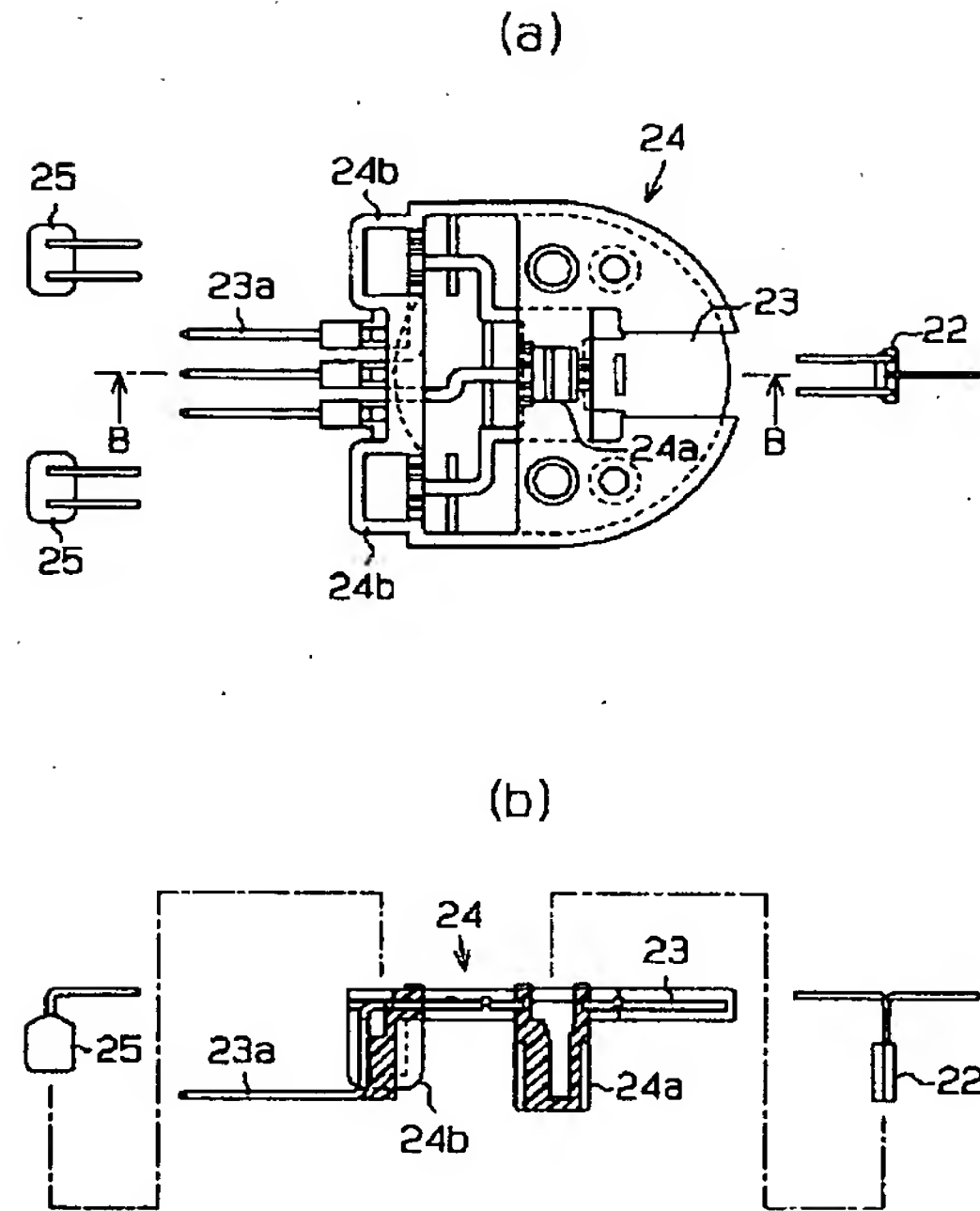
【符号の説明】

- 12 ロータを構成する回転軸
- 21 第2樹脂モールドとしてのコネクタハウジング
- 22 電子部品である磁気検出素子としてのホールIC
- 23 ターミナル
- 24 第1樹脂モールドとしてのモールド
- 24a 位置決め形状及び嵌合形状としてのカップ形状

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 木村 政宏
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機 株式会社内
(72)発明者 奥谷 久義
愛知県刈谷市朝日町2丁目1番地 アイシン精機 株式会社内
(72)発明者 矢田 英利
愛知県刈谷市昭和町2丁目3番地 アイシン・エンジニアリング 株式会社内

(72)発明者 伊東 博義
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車 株式会社内
(72)発明者 西口 正幸
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車 株式会社内
(72)発明者 水野 直紀
愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動車 株式会社内

Fターム(参考) 2F077 AA25 AA47 CC02 JJ01 JJ07
VV02 VV10 VV11 VV23 VV31
VV33 WW03 WW06

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.